

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司上市不满三个完整会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期现金分红规划。

一、 2025 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 394,924,921.76 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 587,496,502.86 元。

经第二届董事会第八次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 129,559,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 129,559,300.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.81%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

根据《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项的规定，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，公司不存在触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2026 年中期现金分红授权安排

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期现金分红方案：在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定 2026 年中期现金分红方案并在规定期限内实施权

益分派，2026 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。独立董事一致同意将该方案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案及 2026 年中期分红规划综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案及 2026 年中期分红规划事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月27日